

## 加熱硬化型耐焊油墨 LM-600 TBK

### THERMAL-CURING TWO-PART SOLDER MASK LM-600 TBK

LM-600 TBK 系列為加熱硬化二液型防焊油墨，具有良好的印刷性、乾燥性。塗膜硬化後具有優異的耐熱性、絕緣性及耐藥品性，可提供在印刷電路板優良的防焊功能。

LM-600 TBK series is a two-parts thermal curing solder mask ink designed for using in printed circuit fabrication. It has fast curing speed, excellent printing properties and forming a tough protective film after thermal curing. The cured film will withstand solder heat, keeping excellent electrical properties, and chemicals resistance for gold plating.

#### 技術資料 Technical Data

項目 Items	LM-600 TBK
顏色 Color	黑色 BLACK
外觀 Appearance	果凍狀(不流動性) Gel like
組成 Formulation	主劑 A：環氧樹脂.色料.有機溶劑.填充料. 硬化劑 B：IMIDAZOLE 誘導體. 填充料.有機溶劑.
硬化條件 Curing conditions	150°C 20 分鐘(第一面) 150°C 30 分鐘(第二面) 150°C 30 分鐘(單面)
混合比例 mixture ratio	主劑 A / 硬化劑 B=9 / 1 (重量比 by weight)
混合後可使用時間 pot life	約 24 小時(hours)但約 6 小時內使用效果較好，時間長光澤性增加。
密著(CROSS CUT)	100 / 100
絕緣阻抗值 electric resistance	$1 \times 10^{14} \Omega$
乳膠膜厚 Stencil thickness	50-100 micron
刮刀 squeegee	75° 度鈍角 angle
網目 Screen Mesh	120-150 Mesh
黏度 A part, Viscosity(25°C)	500 ± 150 PS (VT-04F, #2 針, #2 Spindle)
稀釋 dilution	BCS (不要超過 3%) Less than 3 %
耐焊錫性 Resistance to molten solder	260±5 °C , 10 秒, ≥ 3 次 260±5 °C , 10 seconds, ≥ 3 times
貯存安定性 Shelf life at 20-30 °C under dark packing	12 個月 month
包裝 Packing	1 公斤

以上各項數據僅供參考 The above information is for reference only